



2025年10月22日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)
問 合 わ せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一
(0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6)

当社持分法適用会社（半導体ウエーハ事業）による第三者割当増資に関するお知らせ（第三回）

株式会社フェローテック（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）の半導体ウエーハ事業を行う持分法適用会社である杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下、「CCMC」）が第三者割当増資（第三回）を実施しますので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 増資の背景等

- ・ CCMC はシリコンウエーハメーカーとして小口径（6インチ以下）、8インチ、12 インチの製造能力を持ち、生産能力増強により中国国内でその存在感を高めてきました。直近では浙江省麗水市に第1工場（エピタキシャルウエーハ加工）に続き、12 インチウエーハのインゴット引上げからポリッシュドウエーハまでを一貫生産する麗水第2工場を設置し（2024年12月竣工）、更に供給能力を高めております。
＜現行月産能力＞小口径：40万枚/月、8インチ：40万枚/月、12インチ：30万枚/月
- ・ 資金調達面では過去2回の第三者割当増資（2021年、2022年）を行い、生産能力増強に充当してまいりました。同時に上海証券取引所科创板への上場による資金調達を目指しておりましたが、環境変化から一旦上場申請を取り下げたのち、2025年9月に店頭取引市場である中国新三板（全国中小企業株式譲渡システム、以降「新三板」）に登録承認を受け、CCMC株式の店頭取引を可能にするべく手続きを進めてまいりました。今回、2025年10月22日より新三板でCCMC株式の店頭取引が可能となり、同時に新三板を通じ増資分の株式発行を行う旨、2025年10月21日付で中国にて開示されましたことに伴い本開示を実施しております。
- ・ 今後、麗水第2工場の段階的な製造能力の増強を行いながら、従来拠点（杭州、上海、銀川）製造設備のブラッシュアップを行い、品質の更なる向上、自動化・省人化の推進等を進めてまいります。

2. 調達資金の用途

調達資金の610百万中国元（約131億円）は、主に固定資産購入、有利子負債返済等に充当する予定です。

3. 第三者割当の概要

(1)	発 行 価 額	資本金1中国元たり3中国元（約64円）※1中国元=21.19円	
(2)	出 資 払 込 金 総 額	610百万中国元（約129億円）	
(3)	払 込 期 日	2025年9月（株式発行は2025年10月22日）	
(4)	増 加 資 本 金	203,333千中国元（約43億円）	
(5)	増 加 後 登 録 資 本 金	5,235百万中国元（約1,109億円）	
(6)	割 当 予 定 先 別 割 当 持 分 比 率	No.1 杭州大和热磁电子有限公司(FTH) No.2 杭州工融创新股权投资合伙企业（有限合伙） No.3 诸暨乐谦股权投资合伙企业（有限合伙） No.4 麗水市綠色産業發展基金有限公司 No.5 麗水市国有資本运营有限公司 No.6 海南亿君投资管理中心合伙企业（有限合伙） No.7 宸极投（儋州）中心（有限合伙）成本公司	1.27% 1.27% 0.13% 0.38% 0.25% 0.29% 0.29%

(注) 当該発行価額については、当社及び割当対象者から独立した第三者評価機関である算定機関によって、株式価値の公正価値を算出し、その結果に基づいた価額にて割当てを行っております。

5. 割当予定先の概要

		No. 1	No. 2
(1)	社 名	杭州大和热磁电子有限公司(FTH)	杭州工融创新股权投资合伙企业 (有限合伙)
(2)	資 本 金	677,512 千中国元	50 億中国元
(3)	設 立 年 月 日	1992 年 1 月 31 日	2024 年 12 月 5 日
(5)	代 表 者	賀 賢漢	GP：工銀資本管理有限公司
(6)	事 業 内 容	半導体等装置関連事業、電子デバイス事業	株式投資、創業投資
(7)	上場会社と当該会社との間の関係	当社 100%連結子会社	資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない
(8)	出 資 金 額	2 億中国元 (42 億円)	2 億中国元 (42 億円)

※1 中国元=21.19 円

		No. 3	No. 4
(1)	社 名	诸暨乐谦股权投资合伙企业 (有限合伙)	麗水市綠色産業發展基金有限公司
(2)	資 本 金	5001 万中国元	501 百万中国元
(3)	設 立 年 月 日	2024 年 4 月 11 日	2019 年 6 月 13 日
(5)	代 表 者	GP:杭州元亨利贞私募基金管理有限公司	饶康
(6)	事 業 内 容	株式投資、創業投資 (未上場企業投資)	実業投資、投資管理
(7)	上場会社と当該会社との間の関係	資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない	資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない
(8)	出 資 金 額	2,000 万中国元 (4 億円)	6,000 万中国元 (13 億円)

※1 中国元=21.19 円

		No. 5	No. 6
(1)	社 名	麗水市国有資本运营有限公司	海南亿君投资管理中心合伙企业 (有限合伙)
(2)	資 本 金	15 億中国元	1000 万中国元
(3)	設 立 年 月 日	2017 年 10 月 18 日	2022 年 1 月 18 日
(5)	代 表 者	施海彬	唐蓉
(6)	事 業 内 容	自己資金で投資活動等を行う	自己資金での投資活動、貨物・技術 輸出入、コンサルティングサービス 等
(7)	上場会社と当該会社との間の関係	資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない	資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない
(8)	出 資 金 額	4,000 万中国元 (8 億円)	4,500 万中国元 (10 億円)

※1 中国元=21.19 円

		No. 7
(1)	社 名	宸极投 (儋州) 中心 (有限合伙) 成本公司
(2)	資 本 金	200 万中国元
(3)	設 立 年 月 日	2024 年 3 月 1 日
(5)	代 表 者	史培宇、GP:宸极企业管理 (无锡) 有限公司 (委派代表: 史培宇)
(6)	事 業 内 容	自己資金投資の資産管理サービス、

		融資コンサルティングサービス、自己資金で投資活動、私募基金を用いての株式投資、投資管理、資産管理、私募株式投資基金管理、創業投資基金管理サービス、私募証券投資基金管理サービス、他サービス提供業務等
(7)	上場会社と当該会社との関係	資本・人的・取引の関係は無い 関連当事者に該当しない
(8)	出資金額	4,500 万中国元 (10 億円)

※1 中国元=21.19 円

5. CCMC の概要 (2025 年 8 月 31 日現在)

(1)	名 称	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司 (CCMC)	
(2)	所 在 地	中国浙江省杭州市钱塘新区東塋路 888 号	
(3)	代表者の役職・氏名	法定代表人 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	半導体ウエーハの製造・販売	
(5)	資 本 金	5,032 百万中国元 (約 1,066 億円)	※ 1 中国元=21.19 円
(6)	設 立 年 月 日	2017 年 9 月 28 日	
(7)	当 社 出 資 比 率	(現状)23.05% → (本件後) 23.43%	
(8)	上場会社と当該会社との関係	資 本 関 係	当該会社は当社の持分法適用関連会社です
		人 的 関 係	当社の取締役 1 名が同社の董事を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

6. 今後の見通し

本件による当社の今期業績に与える影響は軽微と見込んでおりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

以 上

<ご参考>

Appendix. CCMCに関する既往開示内容一覧（上場、増資関連）

開示日	表題
2025年10月22日	（開示事項の経過）当社持分法適用会社（半導体ウエーハ事業）株式の中国新三板（店頭登録市場）での取引開始に関するお知らせ
2025年9月24日	（開示事項の経過）当社持分法適用会社（半導体ウエーハ事業）の中国新三板（店頭登録市場）への登録申請承認に関するお知らせ
2025年7月3日	当社持分法適用会社（半導体ウエーハ事業）の中国新三板（店頭登録市場）への登録申請受理に関するお知らせ
2024年7年4日	当社持分法適用会社（半導体ウエーハ）の上場申請取り下げに関するお知らせ
2022年8月30日	半導体ウエーハ持分法適用関連会社による上海証券取引所科创板市場への上場申請に関するお知らせ
2021年10月20日	当社持分法適用関連会社（半導体ウエーハ事業）による海通証券（主幹事証券）との上場に関するアドバイザー契約の締結、および中国証券監督管理委員会による登録受理のお知らせ
2021年9月15日	半導体ウエーハ持分法適用関連会社の第三者割当増資（第二回）の払込完了に関するお知らせ
2021年9月15日	（開示事項の訂正・変更）半導体ウエーハ持分法適用関連会社による第三者割当増資（第二回）および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021年7月15日	（開示事項の変更）半導体ウエーハ持分法適用関連会社による第三者割当増資（第二回）および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021年6月30日	（開示事項の訂正）半導体ウエーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ
2021年6月29日	半導体ウエーハ持分法適用関連会社の上場に関するお知らせ
2021年4月15日	半導体ウエーハ持分法適用関連会社における第三者割当増資（第二回）、および設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ
2021年2月10日	半導体ウエーハ事業子会社の特定子会社の異動に関するお知らせ
2020年11月13日	（開示事項の追加・訂正）半導体ウエーハ子会社の第三者割当増資のお知らせ
2020年11月13日	（開示事項の訂正）半導体シリコンウエーハ子会社の第三者割当増資の払込完了のお知らせ
2020年11月5日	（開示事項の訂正）半導体シリコンウエーハ子会社の株式譲渡代金の払込完了のお知らせ
2020年11月2日	（開示事項の経過）半導体ウエーハ子会社の第三者割当増資の払込完了のお知らせ
2020年10月19日	（開示事項の経過）半導体ウエーハ子会社の株式譲渡代金払込完了のお知らせ
2020年10月16日	半導体ウエーハ子会社による第三者割当増資に関するお知らせ
2020年9月17日	（開示事項の追加・訂正）半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ
2020年9月15日	半導体ウエーハ子会社の株式一部譲渡のお知らせ